

SPI フォーラム 「ムーアの法則を超える新実装技術  
 ～2015年に半導体のターニングポイントが来る」  
 日時：2012年12月13日(木) 13:15～17:20  
 会場：SEMI ジャパン 大島ビル5階  
 主催：株式会社セミコンダクタポータル  
 共催：Total Process Solution Study (TPSS) Group  
 後援：SEMI ジャパン パッケージ委員会

最近の半導体産業では、More Moore よりも More than Moore で価値を創造しようという動きがあります。CMOS 回路の単なる微細化で高性能や高機能、低消費電力を実現するのではなく、CMOS 回路に MEMS センサやパワーデバイス、など全く違う別のチップを集積して機能を上げようという狙いがある背景にあります。その実現手段の一つが、実装技術です。これまでの半導体後工程技術は、前工程とは独立していることが多かったのですが、3次元ICの考え方が出てから、後工程と前工程の技術が接近してきました。TSV やインターポーザなどはその新しい技術です。最近ではガラスインターポーザという考えも出てきました。そこで、シリコンチップを実装する最近の技術について、何故こうした新技術が必要なのか、熱や電磁気に関する技術的課題、そしてその解決方法について専門家に語っていただくセミナーを設けることにしました。この機会を是非ともご活用頂きご参加をお願い申し上げます。

◆プログラムスケジュール(予定)12月13日(木)

13:15-13:30	「セミナーの趣旨説明」	エー・アイ・ティ 代表取締役	加藤 凡典氏
13:30-14:45	基調講演「高速処理方式、低消費電力化、熱対策」	明星大学名誉教授	大塚 寛治氏
14:45-15:15	「新 DRAM アーキテクチャーと実装技術」	株式会社 実装パートナーズ 代表取締役	安生 一郎氏
15:15-15:45	休憩		
15:45-16:15	「Beyond 10Gb/s」	株式会社 エーイーティ 技術本部長	清野 幹雄氏
16:15-17:00	「2.5D/3D 集積の課題と挑戦」	株式会社 CDES 代表取締役	宇都宮 久修氏
17:00-17:20	まとめと全体の質疑応答		
17:20	閉会		

注)プログラムは変更される可能性があります。ご了承ください。

◆会場

SEMI ジャパン大島ビル5階 Room 1,2,3 会議室  
 〒102-0074 東京都千代田区九段南 4-7-13  
 大島ビル 5F (1階は眼鏡店 オグラ)  
 TEL:03-3222-5755(代)  
<http://www.semi.org/jp/About/ContactUs>



交通：JR市ヶ谷駅より徒歩5分/東京メトロ有楽町線・南北線市ヶ谷駅より徒歩5分/都営地下鉄市ヶ谷駅A3出口よりすぐ

◆参加費用(税込)

セミコンポータル会員 5,000 円/人  
 非会員 25,000 円/人

(上記価格にテキスト代を含みます)

※12月7日以降のキャンセルはお受けできませんので、代理の方のご出席をお願いします。

◆参加登録

下記オンライン登録にてお申し込み下さい。

<http://www.semiconportal.com/spiforum/1212/>

◆セミコンポータル パートナー会員ご招待について

セミコンポータルのパートナー会員には、一定数の招待枠があります。

それぞれセミコンポータルの窓口の方にご確認ください。

◆セミコンポータル 会員価格について

セミコンポータルの会員価格適用には、オンライン登録時に、セミコンポータルの Web サイトにログインしていることが必要となります。ID とパスワードをお確かめください。

なお、本セミナーの協賛(TPSS)ならびに後援(SEMI Japan 委員会関係)の関係各位は、下記にてご参加頂けます。(下記特典を使われる場合は、[aitkato@attglobal.net](mailto:aitkato@attglobal.net) へ参加希望のご連絡をメールにてお願申し上げます。)

\* TPSS 正会員及びサテライト会員 1名まで無料 2名以上 5,000 円/人

\* SEMI Japan 委員会委員 5,000 円/人

◆募集人員 40名